

CONUFL001-SMD ✓ 有效

TE 内部编号 CONUFL001-SMD

UMCC GEN 1 Connector, Jack, 50 ohm, Snap-On, 6 GHz, 1

Position, Printed Circuit Board, Board Mount, -40 – 90 °C [-40 – 194 °

F], Solder, Straight

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口: UMCC GEN 1

射频连接器种类: **插座**

阻抗: 50 Ω

射频连接器耦合机制: **搭锁式**

工作频率: 6 GHz

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
射频接口	UMCC GEN 1
射频连接器种类	插座
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	黄铜
主体材料表面涂层	电镀
主体电镀材料	金

接触件特性

射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
---------------	--------



射频连接器中心端子材料 黄铜

端接特性

PCB 端接方法 表面贴装

线缆端接方法 焊接

机械附件

射频连接器耦合机制 搭锁式

连接器安装类型 板安装

射频端子吸附方法 机械

制动器 不带

使用环境

工组温度范围 -40 – 90 °C[-40 – 194 °F]

操作/应用

电路应用 Signal

工作频率 6 GHz

其他

电介质材料 液晶聚合物

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU 符合且适用豁免

欧盟ELV指令2000/53/EC 未进行合规性审核

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 受限材料超出阈值

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
尚未进行合规性审核

卤素含量 尚未进行卤素含量审核

焊接工艺能力 尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院

在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件





文档

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_CONUFL001-SMD_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_CONUFL001-SMD_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_CONUFL001-SMD_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[MICRO COAXIAL SURFACE MOUNT CONNECTOR](#)

英文版本